

# 電子デバイス実装研究委員会および有機/無機接合研究委員会 合同オンライン研究委員会

(第 41 回電子デバイス実装研究委員会、第 15 回有機/無機接合研究委員会)

日時：2022 年 12 月 13 日 (火) 13:00～16:00

オンライン開催

## プログラム

---

司会 小林 竜也 (群馬大学)

13:00～13:05 開会挨拶

電子デバイス実装研究委員会 委員長 福本 信次

有機/無機接合研究委員会 委員長 荘司 郁夫

13:05～13:45

『in-situ 実装ひずみモニタリングによる超音波フリップチップ接合挙動の可視化』(40 分)

.....○生田 敬子<sup>\*1</sup>、糸井 清一<sup>\*1</sup>、常政 慧<sup>\*2</sup>、櫻井 大輔<sup>\*1</sup>、浅野 種正<sup>\*3</sup>

(\*<sup>1</sup>パナソニック ホールディングス(株)、\*<sup>2</sup>パナソニック コネクト(株)、\*<sup>3</sup>九州大学)

13:45～14:25

『排熱回収向け熱電変換素子の高信頼性接合技術』(40 分)

.....○東平 知丈 ((株)日立製作所)

14:25～14:40 休憩

司会 松嶋 道也 (大阪大学)

14:40～15:20

『接着の力学的試験方法と継手の強度評価事例』(40 分)

.....○森 きよみ (拓殖大学)

15:20～16:00

『パワーモジュールにおける金属基板-封止樹脂界面の低サイクル疲労き裂進展』(40 分)

.....○池田 徹<sup>\*1</sup>、中川 柊<sup>\*1</sup>、小金丸 正明<sup>\*1</sup>、加々良 剛志<sup>\*2</sup>

(\*<sup>1</sup>鹿児島大学、\*<sup>2</sup>住友ベークライト(株))

( ) 内時間は、質疑応答時間を含む

---

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会